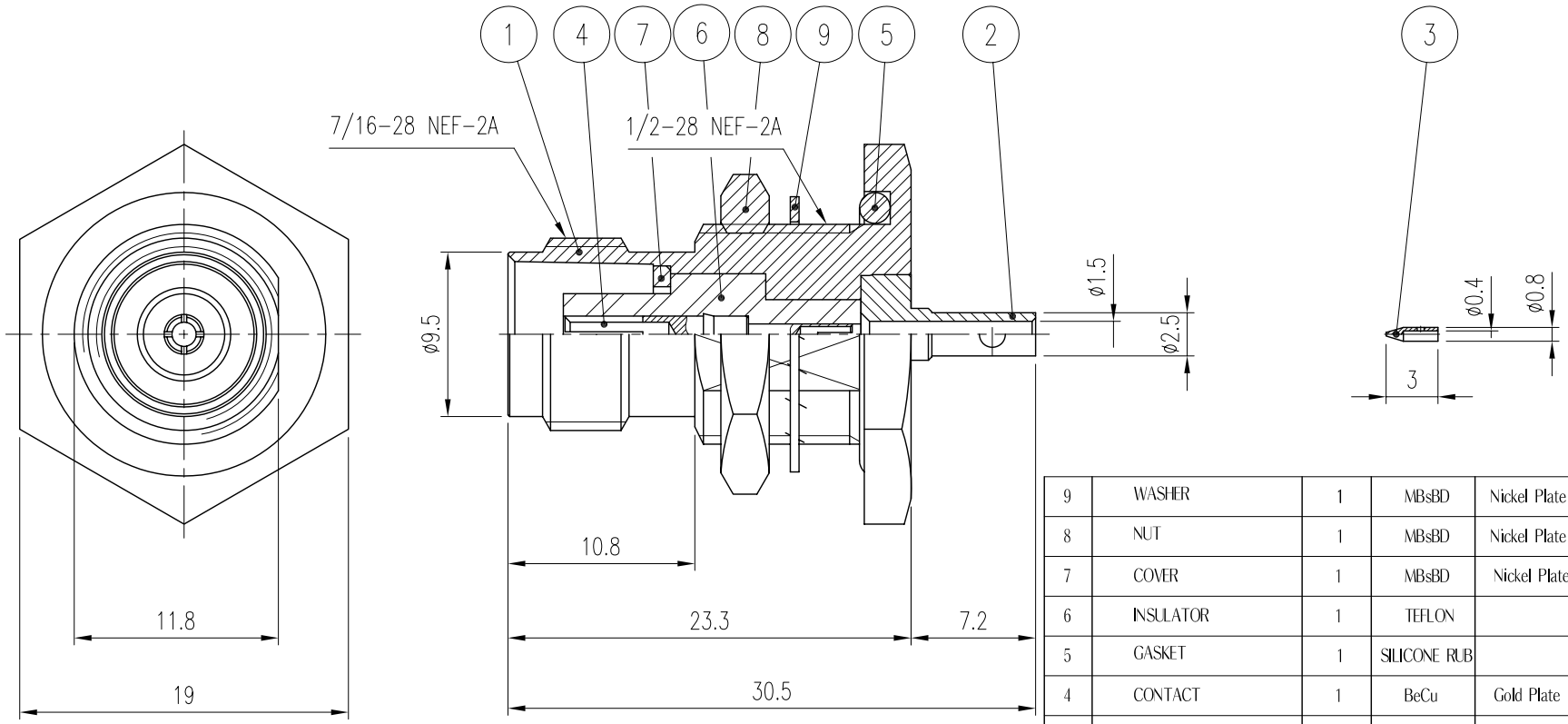
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	가공성 향상(설변No.연구2005-279) (작업 공정 용이-BODY 분할)	김은희	최충락	2005. 11. 29.
2	조립성 향상(설변No.연구2006-241) (BODY 억지끼움 부 치수변경)	김은희	윤상진	2006. 12. 21.



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
9	WASHER	1	MBsBD	Nickel Plate	DWA00022-5/1 (Q6008)
8	NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DNT00020-5/1 (N6002)
7	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00051-5/1 (L7009)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00512-N/1 (H7071)
5	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00036-N/1 (G6007)
4	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00500-5/1 (E7042)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00100-5/1 (E2007)
2	BODY(B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01317-5/1 (D7118B)
1	BODY(A)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00766-5/1 (D7118A) ~~D7118~~

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2005. 11. 4.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 1.5/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 TNC-BJ-S-047 VER.2

A4

도번 CN02078-7/1

K335-343-003